5254012201 EEB IA ENGLISH БЪЛГАРСКИ FRANÇAIS ΕΛΛΗΝΙΚΑ ITALIANO PORTUGUÊS ROMÂNĂ ESPAÑOL TÜRKÇE

Light-Cured Dental Adhesive

TOKUYAMA EE-BOND

CE 0639

Last updated 2022-02-28 Rev.B

ENGLISH

Read all information, precautions and notes before using.

■PRODUCT DESCRIPTION AND GENERAL INFORMATION

1. TOKUYAMA EE-BOND is a light-cured fluoride releasing dental adhesive system which contains TOKUYAMA ETCHING GEL HV (etching agent for enamel etching technique) and EE-BOND (one component light-cured bonding agent for dentin and enamel).
2. Enamel etching technique allows EE-BOND to form a durable bonding layer on dentin and enamel due to good penetration of EE-BOND into both tooth structures. TOKUYAMA EE-BOND exhibits excellent adhesive properties and marginal integrity to enamel and dentin when used in combination with light- or dual-cured composite materials. Its excellent marginal integrity to uncut enamel will enhance esthetic restorations.
3. A light-curing unit having the camphoroquinone (CQ) wavelength range (peak: 470nm, spectrum: 400 to 500nm) can be used for curing EE-BOND.
4. TOKUYAMA ETCHING GEL HV contains 39 wt% Phosphoric acid, Purified water, Thickener, Colorant. EE-BOND contains Phosphoric acid monomer, Bisphenol A di(2-hydroxy propoxy) dimethacrylate (Bis-GMA), Triethylene glycol dimethacrylate, 2-Hydroxyethyl methacrylate (HEMA), Camphoroquinone, and solvent.
5. TOKUYAMA ETCHING GEL HV and EE-BOND are dispensed in syringe and bottle, respectively.

■INDICATIONS

Bonding of light- or dual-cured composite material to:
- cut/uncut enamel,
- cut/uncut dentin,
- fractured porcelain/composite repair.

■CONTRAINDICATIONS

1. DO NOT use TOKUYAMA EE-BOND for patients allergic to or hypersensitive to acids, methacrylic monomers, related monomers, or organic solvents.
2. DO NOT mix TOKUYAMA ETCHING GEL HV and sodium hypochlorite, mixing will generate Chloride gas which is harmful.

■PRECAUTIONS

1) DO NOT use TOKUYAMA EE-BOND for any purpose other than those listed in these instructions. Use TOKUYAMA EE-BOND only as directed herein.
2) TOKUYAMA EE-BOND is designed for sale and use by licensed dental care professionals only. It is not designed for sale nor is it suitable for use by non-dental care professionals.
3) DO NOT use TOKUYAMA EE-BOND if the safety seals are broken or appear to have been tampered with.
4) If TOKUYAMA EE-BOND causes an allergic reaction or oversensitivity, discontinue its use immediately.
5) Use examination gloves (plastic, vinyl or latex) at all times when handling TOKUYAMA EE-BOND to avoid the possibility of allergic reactions from methacrylic monomers. Note: Certain substances/materials may penetrate through examination gloves. If TOKUYAMA ETCHINNG GEL HV or EE-BOND come in contact with the examination gloves, remove and dispose of the gloves, and wash hands thoroughly with water as soon as possible.
6) Avoid contact of TOKUYAMA ETCHING GEL HV or EE-BOND with eyes, mucosal membrane, skin and clothing.
   - If TOKUYAMA ETCHING GEL HV or EE-BOND comes in contact with the eyes, thoroughly flush eyes with water and immediately contact an ophthalmologist.
   - If TOKUYAMA ETCHING GEL HV comes in contact with the mucosal membrane and skin, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water and immediately contact a physician.
   - If EE-BOND comes in contact with the mucosal membrane, wipe the affected area immediately, and thoroughly flush with water the affected area. Affected areas may whiten from protein coagulation, but such whitening should disappear within 24 hours. If such whitening does not disappear within 24 hours, immediately contact a physician, and the patient should be so advised.
   - If EE-BOND comes in contact with the skin, immediately saturate the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze and flush with water.
   - If TOKUYAMA ETCHING GEL HV or EE-BOND comes in contact with clothing immediately saturate the area with alcohol-soaked cotton swab or gauze and flush with water.
   - Instruct the patient to rinse his mouth immediately after treatment.
7) TOKUYAMA EE-BOND should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.
8) To avoid the unintentional ingestion of TOKUYAMA EE-BOND, do not leave it unsupervised within the reach of patients and children.
9) TOKUYAMA EE-BOND should not be ingested or aspirated. Ingestion or aspiration may cause serious injury.
10) To avoid cross contamination, DO NOT reuse the disposable tip and disposable applicator included in the TOKUYAMA EE-BOND package.
11) Clean the dispensing well included in the TOKUYAMA EE-BOND Pack thoroughly with alcohol after each use.
12) When using a light-curing unit, protective eye shields, glasses or goggles should be worn at all times.

■PRECAUTIONS FOR MEDICAMENTS AND MATERIALS

1) Some materials and medicaments (hemostatic material) inhibit adhesion of TOKUYAMA EE-BOND for an extended period, even after meticulous cleansing with water. DO NOT USE products which contain:
   - eugenol,
   - hydrogen peroxide,
   - sodium hypochlorite,
   - diammine silver fluoride [molecular formula: $Ag(NH_3)_2F$],
   - phenols such as parachlorophenol, guaiacol, phenol,
   - aluminum chloride,
   - ferric sulfate,
   - aluminum sulfate,
   - epinephrine.
2) To avoid the mixing of TOKUYAMA ETCHING GEL HV and sodium hypochlorite (sodium hypochlorite included materials and medicaments) when using both in the same procedure, thoroughly rinse before using either.

■STORAGE

1) Store TOKUYAMA ETCHING GEL HV at temperatures between 0 to 25°C (32 to 77°F).
2) Store EE-BOND under refrigeration at temperatures between 0 to 10°C (32 to 50°F).
3) Keep away from heat, direct sunlight, sparks and open flames.
4) DO NOT use after the indicated expiration date on the syringe/bottle/package.

■DISPOSAL

Unused TOKUYAMA ETCHING GEL HV and EE-BOND are to be absorbed into an inert absorbent material such as gauze or cotton, and disposed of in accordance with local regulations.

■CLINICAL PROCEDURES

1. Cleaning
Thoroughly clean the tooth surface with a rubber cup and a fluoride-free paste then rinse with water.
2. Isolation
The rubber dam is the preferred method of isolation.
3. Cavity preparation
Prepare the cavity and rinse with water. Add bevels to the enamel margins of anterior preparations (class III, IV, V), as well as chamfers to the margins between the cavity margins and the restoration, thereby enhancing both esthetics and retention.
- In case of porcelain/composite repairs, roughen the surface with a bur or a diamond point to prepare the area for adhesion, apply TOKUYAMA ETCHING GEL HV for cleaning; rinse thoroughly with water; air dry thoroughly and treat with a silane coupling reagent according to its manufacturer's instructions.
4. Drying
Dry the cavity by using a blotting technique or an air syringe technique.
- DO NOT desiccate the vital tooth. Desiccation can lead to post-operative sensitivity.
- The substances listed below, which inhibit curing of EE-BOND, should be removed from the tooth surface by thoroughly cleaning the tooth surface with alcohol, citric acid, or the application of TOKUYAMA ETCHING GEL HV for 2 to 3 seconds before application:
  1) Oil mist from handpiece,
  2) Saliva, blood and exudates.
5. Pulp protection
Glass ionomer lining or calcium hydroxide should be applied if the cavity is in close proximity to the pulp. DO NOT USE EUGENOL BASED MATERIALS to protect the pulp as these materials will inhibit curing of EE-BOND.
6. Enamel etching
Attach the Disposable Tip after removing the cap of TOKUYAMA ETCHING GEL HV. Verify the flow of TOKUYAMA ETCHING GEL HV prior to applying intra-orally. Apply TOKUYAMA ETCHING GEL HV (39 wt% phosphoric acid-based gel) only to the uncut enamel surrounding margin of prepared cavity and leave TOKUYAMA ETCHING GEL HV in place for 5 seconds. Rinse the etched surface thoroughly (at least 5 seconds) with water, and then dry with mild air. Remove the Disposable Tip from TOKUYAMA ETCHING GEL HV and replace the syringe cap.
- Overfilling of composite materials onto uncut enamel not being etched could cause marginal microleakage and discoloration.
- Cut enamel does not need to be etched. Applying TOKUYAMA ETCHING GEL HV to cut enamel will not improve or impair the adhesive properties of EE-BOND toward cut enamel.
- Applying TOKUYAMA ETCHING GEL HV to dentin may reduce the bond strength of EE-BOND to dentin.
7. Dispensing of EE-BOND
Open the bottle cap of EE-BOND and dispense one or two drops of EE-BOND onto the Dispensing Well. Close the bottle cap tightly immediately after dispensing.
- Wipe off the excess adhesive on the tip of nozzle before closing
- Do not mix the adhesive with other brands of primers or adhesives.
8. Application of EE-BOND
Apply EE-BOND to the cavity walls, margin and surrounding etched uncut enamel using the disposable applicator. Be sure not to leave out any areas where the EE-BOND should be applied. Leave undisturbed for 10 seconds after the end of application.
- Protect the dispensed EE-BOND and the inserted applicator from ambient light before the application using a light blocking plate.
- Complete the EE-BOND application within 5 minutes after dispensing due to the volatile nature of EE-BOND.
- In case of contact of TOKUYAMA ETCHING GEL HV ou EE-BOND avec les yeux, les lèvres, les muqueuses et la peau, rincez immédiatement à l'eau.
- Si l'exposition, le contact de TOKUYAMA ETCHING GEL HV avec les muqueuses et la peau, essuyer immédiatement la zone concernée, laver à grande eau et consulter immédiatement un médecin
- En cas de contact entre EE-BOND et les muqueuses, essuyer la zone touchée immédiatement, et laver à grande eau. La zone touchée peut blanchir à cause de la coagulation protéique, mais un tel blanchiment devrait disparaître dans les 24 heures. Si ce n'est pas le cas, consulter immédiatement un médecin (le patient doit être informé de ce point).
- En cas de contact de EE-BOND avec la peau, saturer immédiatement la zone à l'aide d'un coton ou d'une compresse imbibée d'alcool, puis rincer à l'eau.
- En cas de contact de TOKUYAMA ETCHING GEL HV ou EE-BOND avec les vêtements, saturer immédiatement la zone à l'aide d'un coton ou d'une compresse imbibée d'alcool, puis rincer à l'eau.
- Indiquer au patient de se rincer la bouche immédiatement après le traitement.

7) TOKUYAMA EE-BOND ne doit pas être ingéré ni aspiré. L'ingestion et l'aspiration peuvent entraîner des dommages graves.
8) Afin d'éviter l'ingestion non intentionnelle de TOKUYAMA EE-BOND, ne pas laisser le produit sans surveillance à la portée des patients ou des enfants.
9) NE PAS exposer EE-BOND ou ses vapeurs à une flamme libre car EE-BOND est inflammable.
10) Afin d'éviter une infection croisée, NE PAS réutiliser l'embout jetable ni l'applicateur à usage unique fournis dans la boîte de TOKUYAMA EE-BOND.
11) Nettoyer soigneusement le godet distributeur fourni dans la boîte TOKUYAMA EE-BOND avec de l'alcool après chaque utilisation.
12) En cas d'utilisation d'une lampe à polymériser, porter toujours un masque et des lunettes de protection.

■PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES MEDICAMENTS ET LES MATÉRIAUX

1) Certains matériaux et médicaments (hémostatiques) inhibent l'adhésion de TOKUYAMA EE-BOND pour une longue période, même après un nettoyage méticuleux avec de l'eau. NE PAS UTILISER les produits contenant les substances suivantes:
   - eugénol,
   - eau oxygénée,
   - hypochlorite de sodium,
   - fluorure de diamine-argent [formule brute: $Ag(NH_3)_2F$],
   - phénols tels que parachlorophénol, gaïacol, phénol,
   - chlorure d'aluminium,
   - sulfate de fer,
   - sulfate d'aluminium,
   - épinéphrine (adrénaline).
2) Afin d'éviter tout mélange de TOKUYAMA ETCHING GEL HV et d'hypochlorite de sodium (y compris celui contenu dans les matériaux et les médicaments) lorsqu'ils sont utilisés dans la même procédure, rincer soigneusement avant d'utiliser l'un et l'autre.

■STOCKAGE

1) Stocker TOKUYAMA ETCHING GEL HV à une température comprise entre 0 et 25°C (32 à 77°F).
2) Stocker EE-BOND au réfrigérateur à une température comprise entre 0 et 10°C (32 à 50°F).
3) Garder le produit à l'abri de la chaleur, des rayonnements solaires directs, des étincelles et des flammes libres.
4) NE PAS utiliser après la date de péremption indiquée sur la seringue/flacon/boîte.

■ÉVACUATION

Le produit résiduel de TOKUYAMA ETCHING GEL HV et EE-BOND doit être absorbé avec un matériau absorbant inerte de type compresse ou coton, puis éliminé conformément aux réglementations locales.

■PROCEDURES CLINIQUES

1. Nettoyage
Nettoyez soigneusement la surface dentaire avec une cupule en caoutchouc et une pâte sans fluor, puis rincez à l'eau.
2. Isolation
La digue en caoutchouc est la méthode d'isolation préférable.
3. Préparation de la cavité
Préparez la cavité et rincez à l'eau. Biseauter l'émail en cas de préparation sur les antérieures (classes III, IV, V), ainsi que des chanfreins pour les préparations sur des postérieures (classes I, II) car les biseaux et les chanfreins atténuent les démarcations entre la restauration et la matière dentaire, ce qui augmente l'aspect esthétique et la rétentive.
- En cas de réparation de porcelaine/composite, décaper la surface à l'aide d'une fraise ou d'une pointe diamantée afin de préparer la zone d'adhésion ; appliquer TOKUYAMA ETCHING GEL HV pour le nettoyage, rincer abondamment à l'eau, bien sécher à la soufflette à air et traiter avec un agent de couplage au silane en respectant les instructions du fabricant.
4. Séchage
Sécher la cavité en utilisant une technique de séchage au buvard ou avec une seringue remplie d'air.
- NE PAS dessécher la dent vivante. La dessiccation peut conduire à une sensibilité post-opératoire.
- Les substances listées ci-dessous, qui inhibent la polymérisation de EE-BOND, doivent être éliminées de la surface dentaire par un nettoyage soigneux à l'alcool, à l'acide citrique, ou avec TOKUYAMA ETCHING GEL HV pendant 2 à 3 secondes avant l'application :
  1) Huile issue de la pièce manuelle,
  2) Salive, sang ou exsudats.
5. Protection de la pulpe
Du verre ionomère ou de l'hydroxyde de calcium doit être appliqué si la cavité se situe à proximité immédiate de la pulpe. NE PAS UTILISER DE MATERIAUX À BASE D'EUGÉNOL pour protéger la pulpe car ces substances inhibent la polymérisation de EE-BOND.
6. Mordançage de l'émail
Fixer l'embout jetable après avoir retiré le capuchon de TOKUYAMA ETCHING GEL HV. Vérifier le débit de TOKUYAMA ETCHING GEL HV avant l'application en bouche. N'appliquer TOKUYAMA ETCHING GEL HV (gel de mordançage avec 39 % d'acide phosphorique) que sur l'émail non biseauté entourant la marge de la cavité préparée, et laisser TOKUYAMA ETCHING GEL HV en place pendant 5 secondes. Rincer soigneusement la surface mordancée (5 secondes minimum) à l'eau, puis sécher à l'air doux. Retirer l'embout jetable de TOKUYAMA ETCHING GEL HV et remettre en place le capuchon de la seringue.
- L'excès de remplissage de matériaux composites sur l'émail non biseauté et non mordancé peut provoquer des microfuites marginales et une décoloration.
- Il n'est pas nécessaire de mordancer l'émail biseauté. Une application de TOKUYAMA ETCHING GEL HV pour biseauter l'émail n'améliorera pas ni ne détériorera les propriétés adhésives de EE-BOND envers l'émail biseauté.
- L'application de TOKUYAMA ETCHING GEL HV sur la dentine peut réduire la force d'adhésion entre EE-BOND et la dentine.
7. Préparation de EE-BOND
Ouvrir le capuchon du flacon de EE-BOND et verser une ou deux gouttes de EE-BOND dans le godet d'application. Refermer le flacon immédiatement après.
- Essuyer l'excès d'adhésif sur la pointe de la buse avant de refermer.
- Ne pas mélanger l'adhésif avec des adhésifs ou primers d'autres marques.
8. Application de EE-BOND
Appliquer EE-BOND sur les parois de la cavité, sur la marge et sur l'émail environnant non biseauté et mordancé, à l'aide de l'applicateur jetable. Veiller à ne pas laisser de zones sans adhésif. Laisser reposer pendant 10 secondes après la fin de l'application.
- Avant l'application, protéger de la lumière ambiante EE-BOND distribué et l'applicateur en bouche avec un couvercle opaque.
- Procéder à l'application de EE-BOND dans les cinq minutes après la distribution, car le produit contient un alcool volatil.
- En cas de restaurations multiples, veiller à un temps d'application suffisant pour chaque restauration.
- En cas de contamination de EE-BOND par de la salive, du sang ou d'autres fluides, rincer soigneusement la cavité à l'eau, sécher et appliquer de nouveau EE-BOND.
- Ne pas rincer EE-BOND appliqué avec de l'eau, sauf en cas de contamination involontaire
9. Séchage à l'air
Avec une seringue à eau/air sans huile, appliquer un léger souffle d'air sur la surface de l'adhésif et continuer jusqu'à ce qu'EE-BOND reste immobile dans la même position (habituellement 5 secondes). Ensuite appliquer un fort souffle d'air pendant 5 secondes ou plus. Utiliser un aspirateur pour éviter la projection éventuelle d'éclats de EE-BOND.
- Des projections accidentelles peuvent provoquer la décolloration des tissus ou une réaction allergique.
- Suivre les conseils suivants pour éviter les projections:
  1) Pour éviter un souffle d'air trop violent.
     a) Toujours commencer par un léger souffle d'air en dehors de la bouche,
     b) Diriger le souffle d'air vers la surface de EE-BOND.
  2) Eloigner la seringue à air/eau des dents permet de réduire la puissance du souffle d'air. La technique de réfraction à l'aide d'un miroir est efficace également pour réduire le souffle d'air.
  3) Si l'épaisseur de l'EE-BOND se trouve au fond d'une cavité ou sur une surface angulée et si elle est trop importante pour le souffle d'air, éliminer l'excès avec un nouvel applicateur à usage unique avant d'utiliser le léger souffle d'air.
10. Photopolymérisation
Procédez à une photopolymérisation de la surface pendant 10 secondes ou plus, en gardant la source lumineuse à une distance de 2 mm de la surface. Si la cavité est trop grande ou trop éloignée (ex. MOD), diviser la zone en segments et procédez à une photopolymérisation individuelle de chaque segment.
- Assurez-vous que la lampe à polymériser a bien l'intensité nécessaire (>300 mW/cm²) avant l'utilisation. Notez que des fissures dans le guide lumineux conduisent à une réduction de l'intensité.
11. Composites photopolymérisables
Procédez à la restauration par résine composite photopolymérisable selon les instructions du fabricant. Une fois en place, la résine composite doit être soumise à des finitions soigneuses et un polissage.
- Lorsque les résines composites dual sont placées dans une cavité, le premier incrément doit être photopolymérisé en utilisant une technique par couche.
- Ne pas utiliser de résines composites auto-polymérisables car l'acide phosphoriquemonomère contenu dans EE-BOND peut interférer avec la polymérisation de ces produits, ce qui peut conduire à un décollement prématuré.

L'utilisateur et/ou le patient doivent signaler tout incident grave survenant en lien avec le dispositif au fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

Le fabricant de TOKUYAMA EE-BOND se saurait être tenu pour responsable des dommages ou blessures causé(s) par l'utilisation non conforme de ce produit. L'utilisateur est tenu de s'assurer de la conformité de l'usage de ce produit avant son utilisation.
Les spécifications du produit TOKUYAMA EE-BOND sont sujettes à des modifications sans notification. En cas de changement des spécifications du produit, les instructions et précautions d'utilisation peuvent également être modifiées.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες, προφυλάξεις και σημειώσεις πριν τη χρήση.

■ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το TOKUYAMA EE-BOND είναι ένα φωτοπολυμερίζόμενο οδοντιατρικό σύστημα συγκόλλησης που απελευθερώνει ιόντα φθορίου, το οποίο περιέχει TOKUYAMA ETCHING GEL HV (αδρομοριακός παράγοντας για την τεχνική αδροποίησης της αδαμαντίνης) και EE-BOND (φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας ενός συστατικού για οδοντίνη και αδαμαντίνη).
2. Η τεχνική αδροποίησης της αδαμαντίνης επιτρέπει στο EE-BOND να σχηματίσει ένα στρώμα ανθεκτικού δεσμού στην οδοντίνη και στην αδαμαντίνη λόγω της καλής διείσδυσης του EE-BOND και στις δύο οδοντικές δομές. Το TOKUYAMA EE-BOND διαθέτει εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες και οριακή ακεραιότητα στην αδαμαντίνη και την οδοντίνη, όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με φωτοπολυμεριζόμενα ή διπλού πολυμερισμού υλικά σύνθετης ρητίνης. Η εξαιρετική του οριακή ακεραιότητα σε άκοπη αδαμαντίνη βελτιώνει τις αισθητικές αποκαταστάσεις.
3. Για τον πολυμερισμό του EE-BOND μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μονάδα φωτοπολυμερισμού που έχει το εύρος μήκους κύματος της καμφοροκινόνης (CQ) (μέγιστο: 470 nm, φάσμα: 400 έως 500 nm).
4. Το TOKUYAMA ETCHING GEL HV περιέχει 39% κ.β. φοσφορικό οξύ, κεκαθαρμένο ύδωρ, πυκνωτικό μέσο, χρωστική. Το EE-BOND περιέχει μονομερές φοσφορικού οξέος, δισφαιριλο-Α δι(2-υδροξυπροπιλό) διμεθακρυλικό (Bis-GMA), διαιθυλενογλυκόλη, 2-υδροξυαιθυλ-μεθακρυλικό (HEMA), καμφοροκινόνη, και διαλύτη.
5. Το TOKUYAMA ETCHING GEL HV και το EE-BOND διανέμονται σε σύριγγα και φιάλη, αντίστοιχα.

■ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δυνατόλληση φωτοπολυμεριζόμενου ή διπλού πολυμερισμού υλικού σύνθετης ρητίνης σε:
- κομμένη/άκοπη αδαμαντίνη,
- κομμένη/άκοπη οδοντίνη,
- επιδιόρθωση σπασμένης πορσελάνης/σύνθετης ρητίνης.

■ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε το TOKUYAMA EE-BOND σε ασθενείς με αλλεργία ή υπερευαισθησία στα οξέα, στα μεθακρυλικά μονομερή, συναφή μονομερή ή οργανικούς διαλύτες.
2. ΜΗΝ αναμιγνύετε TOKUYAMA ETCHING GEL HV και υποχλωριώδες νάτριο, καθώς η ανάμιξη θα παράγει χλωριούχο αέριο το οποίο είναι επιβλαβές.

■ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1) Μη χρησιμοποιείτε το TOKUYAMA EE-BOND για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από εκείνους που παρέθεσε σε αυτές τις οδηγίες. Χρησιμοποιείτε το TOKUYAMA EE-BOND μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
2) Το TOKUYAMA EE-BOND προορίζεται για πώληση σε, και για χρήση από, αδειούχους επαγγελματίες οδοντιάτρους μόνο. Δεν προορίζεται για πώληση ούτε είναι κατάλληλο για χρήση από άτομα που δεν είναι επαγγελματίες οδοντίατροι.
3) ΜΗ χρησιμοποιείτε το TOKUYAMA EE-BOND εάν οι σφραγίσεις ασφαλείας έχουν σπάσει ή φαίνεται να έχουν παραβιαστεί.
4) Εάν το TOKUYAMA EE-BOND προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ή υπερευαισθησία, διακόψτε τη χρήση του αμέσως.
5) Χρησιμοποιείτε εξεταστικά γάντια (από πλαστικό, βινύλιο ή λατέξ) ανά πάσα στιγμή όταν χειρίζεστε το TOKUYAMA EE-BOND για να αποφεύγεθεί η πιθανότητα αλλεργικών αντιδράσεων από μεθακρυλικά μονομερή. Σημείωση: Ορισμένες ουσίες/υλικά μπορεί να διαπεράσουν τα εξεταστικά γάντια. Εάν το TOKUYAETCHINNG GEL HV ή EE-BOND έλθει σε επαφή με τα εξεταστικά γάντια, αφαιρέστε και πετάξτε τα γάντια, και πλύνετε τα χέρια σας με νερό το συντομότερο δυνατόν.
6) Αποφύγετε την επαφή του TOKUYAMA ETCHING GEL HV ή EE-BOND με τα μάτια, τον βλεννογόνο, το δέρμα και τα ρούχα.
   - Εάν το TOKUYAMA ETCHING GEL HV ή EE-BOND έλθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια πολύ καλά με νερό και επικοινωνήστε με οφθαλμίατρο αμέσως.
   - Εάν το TOKUYAMA ETCHING GEL HV έλθει σε επαφή με τον βλεννογόνο και το δέρμα, σκουπίστε την επηρεαζόμενη περιοχή αμέσως, ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό και επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό.
   - Εάν το EE-BOND έλθει σε επαφή με τον βλεννογόνο, σκουπίστε την επηρεαζόμενη περιοχή αμέσως και ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό μετά την αποκατάσταση. Οι επηρεαζόμενες περιοχές μπορεί να λευκανθούν από την πήξη της πρωτεΐνης, αλλά αυτή η λεύκανση πρέπει να εξαφανιστεί εντός 24 ωρών. Εάν αυτή η λεύκανση δεν εξαφανιστεί εντός 24 ωρών, επικοινωνήστε αμέσως με γιατρό και συμβουλεύστε τον ασθενή να πράξει το ίδιο.
   - Εάν το EE-BOND έλθει σε επαφή με το δέρμα, διαβρέξτε αμέσως την περιοχή με ένα βαμβάκι ή γάζα εμποτισμένη με αλκοόλη και ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό.
   - Καθοδήγησε τον ασθενή να ξεπλύνει το στόμα αμέσως μετά τη διαδικασία.
7) Απαγορεύεται η κατάποση ή εισπνοή του TOKUYAMA EE-BOND. Η κατάποση ή εισπνοή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
8) Για να αποφύγετε την ακούσια κατάποση του TOKUYAMA EE-BOND, μην το αφήνετε ανεπιτήρητο σε μέρος που το φθάνουν οι ασθενείς και τα παιδιά.
9) ΜΗΝ ακθέτετε το EE-BOND ή τους ατμούς του σε γυμνή φλόγα διότι το EE-BOND είναι εύφλεκτο.
10) Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση, ΜΗΝ επαναχρησιμοποιείτε το αναλώσιμο άκρο και τον αναλώσιμο εφαρμογέα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του TOKUYAMA EE-BOND.
11) Καθαρίζετε την υποδοχή διανομής που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του TOKUYAMA EE-BOND σχολαστικά με αλκοόλη μετά από κάθε χρήση.
12) Κατά τη χρήση μιας μονάδας φωτοπολυμερισμού, πρέπει να φορούνται προστατευτικές ασπίδες ματιών, γυαλιά ή προστατευτικά γυαλιά ανά πάσα στιγμή.

■ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

1) Ορισμένα υλικά και φάρμακα (αιμοστατικό υλικό) αναχαιτίζουν τη συγκόλληση του TOKUYAMA EE-BOND για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και μετά τον σχολαστικό καθαρισμό με νερό. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ προϊόντα που περιέχουν:
   - ευγενόλη,
   - υπεροξείδιο του υδρογόνου,
   - υποχλωριώδες νάτριο,
   - διαμίνη φθοριούχου αργύρου [μοριακός τύπος: $Ag(NH_3)_2F$],
   - φαινόλες όπως παραχλωροφαινόλη, γουαϊακόλη, φαινόλη,
   - χλωριούχο αργίλιο,
   - θειικό σίδηρο,
   - θειικό αργίλιο,
   - επινεφρίνη.
2) Για να αποφύγετε την ανάμειξη TOKUYAMA ETCHING GEL HV και υποχλωριώδους νατρίου (υποχλωριώδες νάτριο που περιλαμβάνεται σε υλικά και φάρμακα) κατά τη χρησιμοποιούνται και τα δύο στην ίδια διαδικασία, ξεπλύνετε το καθένα σχολαστικά πριν χρησιμοποιήσετε το άλλο.

■ΦΥΛΑΞΗ

1) Φυλάσσετε το TOKUYAMA ETCHING GEL HV σε θερμοκρασίες από 0 έως 25°C (32 έως 77°F).
2) Φυλάσσετε το EE-BOND σε ψυγείο σε θερμοκρασίες από 0 έως 10°C (32 έως 50°F).
3) Φυλάσσετε μακριά από θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως, σπινθήρες και γυμνές φλόγες.
4) ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που υποδεικνύεται στη σύριγγα/φιάλη/συσκευασία.

■ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Αχρησιμοποίητο TOKUYAMA ETCHING GEL HV και EE-BOND πρέπει να απορροφάται σε αδρανές απορροφητικό υλικό, όπως γάζα ή βαμβάκι, και να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

■ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1. Καθαρισμός
Καθαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια του δοντιού με ελαστικό κυπελλοειδές και πάστα χωρίς φθόριο, και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
2. Απομόνωση
Ο λάστιχο απομονωτήρας είναι η προτιμώμενη μέθοδος απομόνωσης.
3. Παρασκευή της κοιλότητας
Παρασκευάστε την κοιλότητα και ξεπλύνετε με νερό. Προσθέτετε λοξοτμήσεις στα όρια της αδαμαντίνης των παρασκευών των προσθίων (ομάδα III, IV, V), καθώς και τοξοειδή βάθρα στα όρια των παρασκευών των οπισθίων (ομάδα I, II) διότι οι λοξοτμήσεις και τα τοξοειδή βάθρα βοηθούν στην εξάλειψη των οριοθετήσεων μεταξύ των ορίων της κοιλότητας και της αποκατάστασης, βελτιώνοντας έτσι τόσο την αισθητική όσο και τη συγκράτηση.
- Στην περίπτωση των επιδιορθώσεων πορσελάνης/σύνθετης ρητίνης, τραχύνετε την επιφάνεια με φρέζα ή κόνις διαμαντιών για να προετοιμάσετε την περιοχή για συγκόλληση· εφαρμόστε TOKUYAMA ETCHING GEL HV για καθαρισμό· ξεπλύνετε σχολαστικά με νερό· στεγνώστε πλήρως με αέρα και επεξεργαστείτε με ένα αντιδραστήριο σύζευξης σιλανίου σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες του κατασκευαστή.
4. Στέγνωμα
Στεγνώστε την κοιλότητα χρησιμοποιώντας τεχνική στύσιμου ή τεχνική αεροσύριγγας.
- ΜΗΝ αφυδατώνετε το ζωντανό δόντι. Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε μετεγχειρητική ευαισθησία.
- Οι ουσίες που παρατίθενται παρακάτω, οι οποίες αναχαιτίζουν τον πολυμερισμό του EE-BOND, πρέπει να αφαιρούνται από την οδοντική επιφάνεια καθαρίζοντας σχολαστικά την οδοντική επιφάνεια με αλκοόλη, κιτρικό οξύ, ή με την εφαρμογή του TOKUYAMA ETCHING GEL HV για 2 έως 3 δευτερόλεπτα πριν την εφαρμογή:
  1) Νέφος λαδιού από τη χειρολαβή,
  2) Σάλιο, αίμα και εξιδρώματα.
5. Προστασία του πολφού
Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα υαλοϊονομερές συσέτερου στρώματος ή υδροξείδιο του ασβεστίου εάν η κοιλότητα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον πολφό. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΑΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΥΓΕΝΟΛΗ για προστασία του πολφού, καθώς αυτά τα υλικά θα αναχαιτίσουν τον πολυμερισμό του EE-BOND.
6. Αδροποίηση αδαμαντίνης
Συνδέστε το αναλώσιμο άκρο αφού αφαιρέσετε το πώμα του TOKUYAMA ETCHING GEL HV. Επαλήθευστε τη ροή του TOKUYAMA ETCHING GEL HV πριν την εφαρμογή του ενδοστοματικά. Εφαρμόστε TOKUYAMA ETCHING GEL HV (γέλη αδροποίησης 39% κ.β. φοσφορικό οξέος) μόνο σε άκοπη αδαμαντίνη γύρω από τα όρια της παρασκευασμένης κοιλότητας και αφήστε το TOKUYAMA ETCHING GEL HV τοποθετημένο για 5 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε την αδροποιημένη επιφάνεια σχολαστικά (τουλάχιστον για 5 δευτερόλεπτα) με νερό και στη συνέχεια στεγνώστε με ήπιο ρεύμα αέρα. Αφαιρέστε το αναλώσιμο άκρο από το TOKUYAMA ETCHING GEL HV και αντικαταστήστε το με το πώμα σύριγγας.
- Η υπερπλήρωση με υλικά σύνθετης ρητίνης επάνω σε άκοπη αδαμαντίνη που δεν έχει αδροποιηθεί μπορεί να προκαλέσει οριακή μικροδιαφυγή και δυσχρωμία.
- Η κομμένη αδαμαντίνη δεν χρειάζεται αδροποίηση. Η εφαρμογή του TOKUYAMA ETCHING GEL HV σε άκοπη αδαμαντίνη δεν θα βελτιώσει ή ελαττώσει τις συγκολλητικές ιδιότητες του EE-BOND προς την κομμένη αδαμαντίνη.
- Η εφαρμογή TOKUYAMA ETCHING GEL HV στην οδοντίνη μπορεί να μειώσει τη ισχύ συγκόλλησης του EE-BOND στην οδοντίνη.
7. Διανομή του EE-BOND
Ανοίξτε το πώμα της φιάλης του EE-BOND και διανείμετε μία ή δύο σταγόνες EE-BOND επάνω στην κοιλότητα διανομής. Κλείστε το πώμα της φιάλης ερμητικά αμέσως μετά τη διανομή.
- Σκουπίστε το περίσσευμα συγκολλητικό από το άκρο του ρύγχους πριν το κλείσιμο.
- Μην αναμιγνύετε το συγκολλητικό με άλλες μάρκες πρίμερ ή συγκολλητικών.
8. Εφαρμογή του EE-BOND
Εφαρμόστε το EE-BOND στα τοιχώματα, τα όρια και τη γύρω αδροποιημένη άκοπη αδαμαντίνη της κοιλότητας χρησιμοποιώντας τον αναλώσιμο εφαρμογέα. Βεβαιωθείτε ότι δεν παραλείψατε οποιεσδήποτε περιοχές όπου θα έπρεπε να εφαρμοστεί το EE-BOND. Αφήστε το ανενόχλητο για 10 δευτερόλεπτα μετά το τέλος της εφαρμογής.
- Προστατεύετε το διανεμημένο EE-BOND και τον εισαγμένο εφαρμογέα από τον φωτισμό του περιβάλλοντος πριν την εφαρμογή χρησιμοποιώντας μια πλάκα αποκλεισμού φωτός.
- Ολοκληρώστε την εφαρμογή του EE-BOND εντός 5 λεπτών μετά τη διανομή λόγο της περιεκτικότητας σε πτητική αλκοόλη.
- Στην περίπτωση πολλαπλών αποκαταστάσεων, διασφαλίστε τον επιμέρους χρόνο εφαρμογής για κάθε αποκατάσταση.
- Για τον πολυμερισμό του EE-BOND μπορεί να χρ

accurato prima dell'uso di ciascuno di ESSI

■CONSERVAZIONE
1) Conservare TOKUYAMA ETCHING GEL HV a temperature comprese tra 0 e 25°C (32 e 77°F).
2) Conservare EE-BOND in frigorifero a temperature comprese tra 0 e 10°C (32 e 50°F).
3) Tenere lontano da fonti di calore, luce solare diretta, scintille e fiamme libere.
4) NON utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla siringa/flacone/confezione.

■SMALTIMENTO
Si raccomanda di assorbire TOKUYAMA ETCHING GEL HV e EE-BOND non utilizzati con un materiale assorbente inerte, ad esempio una garza o cotone, e smaltirlo in conformità ai regolamenti locali.

■PROCEDURE CLINICHE
1. Pulizia
Pulire accuratamente la superficie del dente con una coppetta in gomma e una pasta detergente priva di fluoro, poi sciacquare con acqua.
2. Isolamento
Il miglior metodo di isolamento è la diga in lattice.
3. Preparazione della cavità
Preparare la cavità e sciacquare con acqua. Praticare un bisello sui margini dello smalto delle preparazioni anteriori (classe III, IV, V), nonché un chamfer sui margini delle preparazioni posteriori (classe I, II), poiché biselli e chamfer sono d'aiuto nell'eliminazione della demarcazione tra i margini cavitari e il restauro, migliorando così sia l'aspetto estetico sia la ritenzione.
- In caso di riparazioni su porcellana/composito, irruvidire la superficie con una fresa o una punta diamantata per preparare l'area all'adesione; applicare TOKUYAMA ETCHING GEL HV per la pulizia; sciacquare accuratamente con acqua; asciugare a fondo con aria e trattare con prodotto silanizzante attenendosi alle istruzioni del produttore.

4. Asciugatura
Asciugare la cavità utilizzando una tecnica "blotting" o una siringa piena d'aria.
- NON essicare il dente vitale. L'essiccazione può causare sensibilità post-operatoria.
- Le sostanze elencate di seguito, che pregiudicano l'adesione di EE-BOND, devono essere eliminate dalla superficie dentale mediante pulizia accurata con alcool, acido citrico o l'applicazione di TOKUYAMA ETCHING GEL HV per 2 - 3 secondi, prima dell'applicazione:
  1) Nebulizzazione contaminata con l'olio del manipolo,
  2) Saliva, sangue ed essudato.

5. Protezione della polpa dentale
Se la cavità dentale si trova nelle immediate vicinanze della polpa, si raccomanda di applicare un rivestimento vetroionomerico o idrossido di calcio. NON USARE MATERIALI A BASE DI EUGENOLO per proteggere la polpa, poiché tali materiali inibiscono la polimerizzazione di EE-BOND.
6. Mordenzatura dello smalto
Collegare la punta monouso dopo aver rimosso il cappuccio di TOKUYAMA ETCHING GEL HV. Verificare il flusso di TOKUYAMA ETCHING GEL HV prima di procedere all'applicazione intraorale. Applicare TOKUYAMA ETCHING GEL HV (gel mordenzante con 39 % di peso di acido fosforico) sullo smalto non fresato circondante al margine della cavità preparata e lasciare TOKUYAMA ETCHING GEL HV in pausa per 5 secondi. Sciacquare accuratamente con acqua (almeno 5 secondi) la superficie mordenzata e poi asciugare con aria a getto leggero. Rimuovere la punta monouso dal TOKUYAMA ETCHING GEL HV e apporre il nuovo il cappuccio della siringa.
- Il riempimento eccessivo di materiali compositi su smalto non fresato che non è stato mordenzato può provocare microperdite e discolorazione marginale.
- Lo smalto fresato non richiede mordenzatura. L'applicazione di TOKUYAMA ETCHING GEL HV sullo smalto fresato non migliorerà o deteriorerà le proprietà adesive di EE-BOND sullo smalto fresato.
- L'applicazione di TOKUYAMA ETCHING GEL HV sulla dentina può ridurre la forza di adesione di EE-BOND alla dentina.

7. Erogazione di EE-BOND
Aprire il cappuccio di EE-BOND ed erogare una o due gocce di EE-BOND sul pozzetto per la lavorazione. Chiudere bene il cappuccio subito dopo l'erogazione.
- Prima di chiudere, eliminare l'adesivo in eccesso dalla punta dell'ugello.
- Non miscelare l'adesivo con primer o adesivi di altre marche.

8. Applicazione di EE-BOND
Utilizzando l'applicatore monouso, applicare EE-BOND alle pareti della cavità, ai margini e allo smalto circostante mordenzato non fresato. Accertarsi di aver applicato EE-BOND su tutte le aree. Lasciare in posa per 10 secondi dopo la fine dell'applicazione.
- Proteggere EE-BOND erogato e l'applicatore dalla luce ambiente prima dell'applicazione mediante una piastra foto-bloccante.
- Completare l'applicazione dell'EE-BOND entro 5 minuti dall'erogazione, la volatilità dell'alcool contenuto potrebbe modificare le caratteristiche del prodotto.
- In caso di restauri multipli, prevedere un tempo di applicazione per ogni restauro.
- In caso di contaminazione dell'EE-BOND applicato, con saliva, sangue o altri fluidi, sciacquare accuratamente la cavità con acqua, asciugare e riapplicare l'EE-BOND.
- Non sciacquare con acqua l'EE-BOND applicato se non in caso di contaminazione involontaria.

9. Asciugatura con aria
Mediante una siringa aria/acqua esente da oli, applicare un leggero getto d'aria alla superficie dell'adesivo, continuando fino a quando l'EE-BOND semiliquido si trova nella stessa posizione e non si muove più (in genere 5 secondi). Finire con un leggero getto d'aria per 5 secondi o più. Utilizzare un aspiratore per evitare di spruzzare l'EE-BOND.
- Se si verifica uno spruzzo accidentale, questo può causare uno sbiancamento dei tessuti o possibili reazioni allergiche.
- Per prevenire di spruzzare l'adesivo, consultare i seguenti suggerimenti:
  1) Per evitare di applicare inavvertitamente un forte getto d'aria;
     a) Verificare di iniziare con un leggero getto d'aria fuori dalla bocca,
     b) Dirigere il flusso d'aria sulla superficie dell'EE-BOND.
  2) Estendendo la distanza della siringa aria/aria dal dente si riduce il flusso d'aria. Anche la tecnica di rifrazione dello specchio è utile nella riduzione del flusso d'aria.
  3) Se l'EE-BOND sul fondo della cavità o sull'angolo della superficie è troppo spesso per il getto d'aria leggero, assorbire la quantità in eccesso con un nuovo applicatore monouso prima di applicare un leggero getto d'aria.

10. Polimerizzazione
Fotopolimerizzare la superficie per 10 secondi o più, tenendo la punta a una distanza di 2 mm dalla superficie stessa. Se la cavità è troppo grande o troppo distante (ad es. MOD), dividere l'area in segmenti ed eseguire la fotopolimerizzazione su ciascun segmento.
- Prima dell'uso, verificare che l'unità di fotopolimerizzazione sia di intensità sufficiente (>300 mW/cm²). Si segnala che l'uso di un puntale incrinato riduce l'intensità.

11. Composito fotopolimerizzabile
Eseguire il restauro con resina composita fotopolimerizzabile secondo le istruzioni del produttore. Si raccomanda di rifinire e lucidare accuratamente la resina composita.
- Se si inseriscono in una cavità resine composite a indurimento duale, si consiglia di fotopolimerizzare il primo incremento e poi procedere con la tecnica incrementale.
- Non utilizzare resine composite autoindurenti poiché l'acido fosforico monomero contenuto nel EE-BOND può interferire con la polimerizzazione di tali resine, causandone il distacco prematuro.

L'utente e/o il paziente sono tenuti a segnalare qualsiasi evento avverso grave occorso in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui l'utente e/o il paziente risiedono.

Il produttore del TOKUYAMA EE-BOND non è responsabile di danni o lesioni causate dall'uso improprio di questo prodotto. Rientra nella personale responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi, prima dell'uso, che il prodotto sia idoneo per il tipo di applicazione prevista.
Le specifiche del TOKUYAMA EE-BOND sono soggette a modifiche senza preavviso. La variazione delle specifiche del prodotto può comportare anche la modifica delle istruzioni e delle precauzioni d'uso.

PORTUGUÊS

Antes de usar leia atentamente todas as informações, precauções, e notas.

■Descrição do produto e informação geral
1. TOKUYAMA EE-BOND é um sistema adesivo dentário fotopolimerizável que libera flúor e que contém TOKUYAMA ETCHING GEL HV (agente de gravação para a técnica de gravação de esmalte) e EE-BOND (agente monocomponente de adesão, fotopolimerizável para dentina e esmalte).
2. A técnica de gravação de esmalte permite que o EE-BOND forme uma camada adesiva duradoura sobre a dentina e o esmalte em vitrude da boa penetração do EE-BOND nas duas estruturas do dente. TOKUYAMA EE-BOND apresenta excelentes propriedades de adesão e excelente integridade marginal para o esmalte e a dentina quando combinado com resinas compostas fotopolimerizáveis ou de dupla polimerização. A sua excelente adesão marginal em esmalte não bisotado potencia as restaurações estéticas.
3. Uma unidade de fotopolimerização que abranja os comprimentos de onda de activação de camphorquinonas (CQ) (pico: 470 nm, espectro: 400 a 500 nm), pode ser usada na polimerização do sistema adesivo EE-BOND.
4. TOKUYAMA ETCHING GEL HV contém 39 % em peso de ácido fosfórico, água purificada, espessante, corante. EE-BOND contém monómeros de ácido fosfórico, Bisfenol A di (2-hidroxi propoxi) dimetacrilato (Bis-GMA), Trietileno glicol dimetacrilato, 2 Hidroxietil metacrilato (HEMA), Canforoquinonas, álcool, e solvente.
5. TOKUYAMA ETCHING GEL HV e EE-BOND são distribuídos em seringa e garrafa, respectivamente.

■Indicações
Adesão de resinas compostas fotopolimerizáveis ou de dupla polimerização:
- Esmalte preparado e não preparado,
- Dentina preparada e não preparada,
- reparação de fraturas de restauros em cerâmica ou resina composta.

■Contra-Indicações
1. Não use TOKUYAMA EE-BOND em pacientes com histórico de alergia ou de hipersensibilidade a ácidos, monomeres de metacrilato e monomeros relacionados ou solventes orgânicos.
2. NÃO misture TOKUYAMA ETCHING GEL HV e hipoclorito de sódio, porque esta mistura produzirá gás cloreto que é nocivo.

■Precauções
1) Não usar TOKUYAMA EE-BOND para qualquer outro tipo de aplicações que não sejam referidos nestas instruções. Use TOKUYAMA EE-BOND apenas no sentido das instruções.
2) TOKUYAMA EE-BOND foi desenvolvido para venda e uso exclusivo a profissionais de saúde oral licenciados. Não foi desenvolvido para venda e nem é adequado a pessoal não qualificado na área de saúde oral.
3) Não usar TOKUYAMA EE-BOND se os sebes de segurança se encontrarem quebrados ou danificados.
4) Se TOKUYAMA EE-BOND causar reacção alérgica ou de hipersensibilidade descontinuo o seu uso imediatamente.
5) Use sempre que manipular TOKUYAMA EE-BOND luvas de examinação (plástico, vinyl ou látex) para evitar a possibilidade de reacções alérgicas aos monómeros de metacrilato. Nota – Certas substâncias/materiais podem penetrar através das luvas de examinação. Se TOKUYAMA ETCHING GEL HV ou EE-BOND entrar em contacto com as luvas de exame, retire e descarte as luvas e lave as mãos cuidadosamente com água assim que for possível.
6) Evitar o contacto de TOKUYAMA ETCHING GEL HV ou EE-BOND com os olhos, membranas mucosas, pele e roupa.
- Se TOKUYAMA ETCHING GEL HV ou EE-BOND entrar em contacto com os olhos, lave com água em abundância e consulte imediatamente um oftalmologista.
- Se TOKUYAMA ETCHING GEL HV entrar em contacto com a membrana mucosa ou a pele, limpe imediatamente a área afectada, lave com água em abundância e consulte um médico imediatamente.
- Se o TOKUYAMA EE-BOND entrar em contacto com as membranas mucosas limpe imediatamente a área afectada e lave abundantemente com água depois de terminada a restauração. As zonas afectadas podem adquirir uma aparência esbranquiçada devido à coagulação proteica, mas a referida lesão deve desaparecer nas 24 horas seguintes. Se tal não acontecer contate imediatamente um médico avisando também o paciente.
- Se EE-BOND entrar em contacto com a pele, sature de imediato a área com uma gaze ou compressa de algodão embebida em álcool e lave com água.
- Se TOKUYAMA ETCHING GEL HV ou EE-BOND entrar em contacto com a roupa, sature de imediato a área com uma gaze ou compressa de algodão embebida em álcool e lave com água
- Instruir o paciente a enxaguar a sua boca imediatamente após o tratamento.
7) TOKUYAMA EE-BOND não deve ser ingerido ou aspirado. A sua ingestão ou aspiração pode causar lesões graves.
8) De forma a evitar a ingestão acidental TOKUYAMA EE-BOND não deixe nunca de supervisionar em crianças ou pacientes.
9) Nunca expor EE-BOND ou os seus vapores a fontes de calor visto ele ser inflamável.
10) Para evitar uma contaminação cruzada, NÃO reutilize a ponta descartável e o aplicador descartável incluso na embalagem de TOKUYAMA EE-BOND.
11) O dispensador incluído no kit de TOKUYAMA EE-BOND deve ser limpo abundantemente com alcóol após cada utilização.
12) Durante o uso de uma unidade de fotopolimerização deve ser usada protecção ocular apropriada.

■Precauções com medicamentos e materiais
1) Alguns materias e medicamentos (material hemostático) inibem a adesão do TOKUYAMA EE-BOND por um período prolongado, mesmo após lavagem meticulosa com água. Não usar produtos que contenham:
- Eugenol,
- Peróxido de Hidrogénio,
- Hipoclorito de Sódio,
- Diamino fluoreto de prata [formula molecular: $Ag(NH_3)_2F$],
- Fenóis tais como paraclorofenol, guaiacol, fenol,
- Cloreto de Alumínio,
- Sulfato férrico,
- Sulfato de Alumínio,
- Epinefrina.

2) Para evitar misturar TOKUYAMA ETCHING GEL HV e hipoclorito de sódio (hipoclorito de sódio incluso em materiais e medicamentos) ao utilizar ambos no mesmo procedimento, enxágue completamente antes de usar cada um deles.

■Armazenamento
1) Conserve TOKUYAMA ETCHING GEL HV em temperaturas entre 0 a 25°C (32 a 77°F).
2) Conserve EE-BOND refrigerado em temperaturas entre 0 e 10°C (32 e 50°F).
3) Manter afastado de fontes de calor e luz solar directa.
4) NÃO use após o vencimento do prazo de validade indicado na seringa/garrafa/embalagem.

■Descarte
1) TOKUYAMA ETCHING GEL HV e EE-BOND não usados devem ser absorvidos por material absorvente como gazes ou algodão, e eliminados de acordo com as regulamentações locais.

■Procedimento clínico
1. Limpeza
Limpe minuto bem a superfície dentária com uma borracha e uma paste sem flúor e de seguida lave com água abundante.
2. Isolamento
O dique de borracha é o método de isolamento preferencial.
3. Preparação cavitaria
Prepare a cavidade e irrigue com água. Faça biseis nas margens de esmalte de dentes anteriormente preparados (classe III, IV e V), assim como chanfros nas margens de dentes posteriormente preparados (classe I e II), porque os biseis e os chanfros são uteis para eliminar demarcações entre as margens da cavidade e a restauração, aumentado assim a estética e a retenção da restauração.
- No caso de reparações em cerâmica/compósito torne a superfície áspera com uma broca ou uma ponta diamantada para preparar a área para a adesão; aplique TOKUYAMA ETCHING GEL HV para limpar; enxágue com água em abundância; seque com ar e trate a superfície com um reagente de ligação de silano de acordo com as instruções do fabricante deste.

4. Secagem
Seque a cavidade com a seringa de ar ou com bolas de algodão.
- Não secar em demasia o dente vital. A desidratação do dente pode conduzir à sensibilidade pós operatória.
- As substâncias listadas abaixo, que inibem a polimerização do EE-BOND, devem ser removidas da superfície do dente pela limpeza completa desta com álcool, ácido cítrico, ou a aplicação do TOKUYAMA ETCHING GEL HV durante 2 a 3 segundos antes da aplicação:
  1) Resíduos de óleo da turbina,
  2) Sangue, saliva e exsudados.

5. Protecção pulpar
Uma base de inómero de vidro ou de hidróxido de cálcio deve ser aplicada na cavidade se existir proximidade pulpar. Não usar materiais com base de Eugenol para proteger a polpa, uma vez que os mesmso inibem a polimerização de EE-BOND.
6. Gravação do esmalte
Junte a Ponta Descartável depois de retirar a tampa do TOKUYAMA ETCHING GEL HV. Verifique o fluxo do TOKUYAMA ETCHING GEL HV antes de o aplicar intra-oralmente. Aplicar TOKUYAMA ETCHING GEL HV (39 % em peso de gel de gravação ácido fosfórico) somente na margem da cavidade não preparada e deixe TOKUYAMA ETCHING GEL HV agir durante 5 segundos. Enxágue a superfície gravada (no mínimo durante 5 segundos) com água e em seguida seque com ar. Remova a Ponta Descartável do TOKUYAMA ETCHING GEL HV e recoloque a tampa da seringa.
- O sobre-enchimento de matriais compósitos sobre esmalte intacto que não estiver sendo gravado pode provocar micro vazamento e descoloração marginal.
- Esmalte desgastado não precisa ser gravado. A aplicação de TOKUYAMA ETCHING GEL HV em esmalte desgastado não melhorará nem prejudicará as propriedades adesivas do EE-BOND face ao esmalte desgastado.
- A aplicação de TOKUYAMA ETCHING GEL HV à dentina pode reduzir a força de adesão do EE-BOND à dentina.

7. Distribuição do EE-BOND
Abra a tampa da garrafa de EE-BOND e verta uma ou duas gotas de EE-BOND no Dispensador.
- Remova o excesso de adesivos sobre a ponta do bocal antes de fechar.
- Não misture o adesivo com os fixadores ou adesivos de outras marcas.

8. Aplicação do EE-BOND
Aplique EE-BOND às paredes da cavidade, à margem e ao esmalte intacto gravado circundante usando o aplicador descartável. Certifique-se de que em todas as áreas necessárias foi aplicado o EE-BOND. Deixe sem pertubações durante 10 segundos depois do fim da aplicação.
- Proteja o EE-BOND e o aplicador inserido da luz ambiente antes da aplicação utilizando uma placa de bloqueio de luz.
- Complete a aplicação do EE-BOND dentro dos 5 minutos depois da devida distribuição para o conteúdo de álcool volátil
- Em caso de restaurações múltiplas assegure um tempo de aplicação individual para cada restauração.
- Se a saliva, o sangue, ou outro fluido contaminar o EE-BOND aplicado, enxágue completamente a cavidade com água, seque e aplique novamente o EE-BOND.
- Não enxágue o EE-BOND aplicado com água exceto se houver contaminação não intencional.

9. Secagem com ar
Com uma seringa de ar/água sem óleo, aplique um leve fluxo de ar na superfície adesiva, continuando até o EE-BOND fluido permaneça na mesma posição sem qualquer movimento (geralmente 5 segundos). Termine com um leve fluxo de ar durante 5 segundos ou mais. Use um aspirador para prevenir que o EE-BOND se disperse para locais não apropriados.
- Se ocorrer um respingo acidental, este poderá causar empaladecimento do tecido ou possível reacção alérgica.
- Para prevenir o respingo do adesivo, consulte as seguintes sugestões:
  1) Para evitar aplicar inadvertidamente um jato forte de ar;
     a) Assegure-se de começar com um jato suave de ar fora da boca,
     b) Dirija o fluxo de ar para a superfície do EE-BOND.
  2) Extendendo a distância da seringa a ar/água desde o dente, reduz-se o fluxo de ar. A técnica de refracção de espelho também é útil para reduzir o fluxo de ar.
  3) Se existirem zonas com excesso de EE-BOND (no pavimento da cavidade e/ou no ângulo cavo-superficial) resistentes à secagem com ar absorva o excesso com novo aplicador descartável antes da secagem com ar suave.

10. Fotopolimerização
Fotopolimerize a superfície durante dez segundos ou mais, mantendo a guia de luz do fotopolimerizador com uma distância de cerca de dois milímetros do dente. Se a cavidade for muito extensa ou de difícil acesso (exemplo MOD), divida a área em secções e fotopolimerize cada uma individualmente.
- Confirme que o aparelho de fotopolimerização tem intensidade suficiente (> 300 mW/cm²). Tenha em conta que pequenas fracturas na guia de luz diminuem a intensidade.

11. Compósito fotopolimerável
Restaure com resinas compostas fotopolimerizáveis de acordo com as instruções dos fabricantes. O restauro deve ser finalizado de acordo com os procedimentos técnicos adequados (acabamento/polimento).
- Quando se utiliza resinas de dupla polimerização o primeiro incremento deve ser fotopolimerizável utilizando a técnica de incremento.
- Não use resinas compostas autopolimerizáveis, devido à presença de monomeros de ácido fosfórico no EE-BOND, que podem interferir com a polimerização das resinas autopolimerizaveis, levando ao seu descolamento prematuro.

O utilizador e/ou o paciente deve/m comunicar qualquer incidente grave ocorrido em relação ao dispositivo ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou paciente está/estão estabelecido/s.

O fabricante do TOKUYAMA EE-BOND não é responsável por lesões ou danos provocados por uso indevido do produto. É da responsabilidade indivual do utilizador garantir que este produto é adequado para aplicação apropriada antes do seu uso.
As especificações do produto TOKUYAMA EE-BOND são sujeitas a alteração sem aviso prévio. Quando as especificações do produto mudarem as instruções e precauções podem também mudar.

ROMÂNĂ

Citiți toate informațiile, măsurile preventive și observațiile înainte de utilizare.

■DESCRIEREA PRODUSULUI ŞI INFORMAŢII GENERALE
1. TOKUYAMA EE-BOND este un sistem adeziv dentar fotopolimerizabil, cu eliberare de fluor, care conține TOKUYAMA ETCHING GEL HV (agent de gravare pentru tehnica gravării smalțului) și EE-BOND (agent adeziv fotopolimerizabil pentru dentină și smalț, cu o singură componentă).
2. Tehnica gravării smalțului permite EE-BOND să formeze un strat adeziv durabil pe dentină și smalț datorită unei bune pătrunderi a componentei EE-BOND în ambele structuri dentare. TOKUYAMA EE-BOND prezintă excelente proprietăți adezive și de integritate marginală față de smalț și dentină atunci când se utilizează în combinație cu materiale compozite fotopolimerizabile sau cu polimerizare duală. Integritatea sa marginală excelentă față de smalțul neslefuit va spori caracterul estetic al restaurărilor.
3. Pentru polimerizarea produsului EE-BOND se poate utiliza un dispozitiv de fotopolimerizare cu intervalul de lungime de undă al camforchinonei (CQ) (peak: 470 nm, spectru: 400 la 500 nm).
4. TOKUYAMA ETCHING GEL HV conține 39% în greutate acid fosforic, apă purificată, agent de îngroșare, colorant. EE-BOND conține monomer de acid fosforic, bisfenol A di(2-hidroxi-propoxi) dimetacrilat (Bis-GMA), trietilen-glicol-dimetacrilat, 2-hidroxietil-metacrilat (HEMA), camforchinonă și solvent.
5. TOKUYAMA ETCHING GEL HV și EE-BOND sunt distribuite în seringă respectiv în sticlă.

■INDICAŢII
Fixarea materialului compozit fotopolimerizabil sau cu polimerizare duală la:
- smalțul șlefuit/neslefuit,
- dentina șlefuită/neslefuită,
- repararea porțelanului/materialului compozit fracturat.

■CONTRAINDICAŢII
1. NU utilizați TOKUYAMA EE-BOND la pacienții alergici sau hipersensibili la acizi, monomerii de metacrilat, cei similari acestora sau la solvenții organici.
2. Nu amestecați TOKUYAMA ETCHING GEL HV cu hipoclorit de sodiu, deoarece amestecarea va genera clor gazos, care este nociv.

■MĂSURI PREVENTIVE
1) NU utilizați TOKUYAMA EE-BOND pentru niciun alt scop decât cele menționate în aceste instrucțiuni. Utilizați TOKUYAMA EE-BOND numai conform acestor instrucțiuni.
2) TOKUYAMA EE-BOND este destinat vânzării și utilizării numai de către profesioniștii licențiați în domeniul stomatologiei. Produsul nu este destinat vânzării și nu este adecvat pentru utilizarea sa de către profesioniștii dinafara domeniului stomatologiei.
3) NU utilizați TOKUYAMA EE-BOND dacă sigiliile de siguranță sunt rupte sau par deteriorate.
4) Dacă TOKUYAMA EE-BOND provoacă o reacție alergică sau o hipersensibilitate, renunțați imediat la utilizarea sa.
5) Utilizați mănuși de examinare (plastic, vinil sau latex) întotdeauna când manipulați TOKUYAMA EE-BOND pentru a evita posibilitatea reacțiilor alergice la monomerii de metacrilat. Observație: Anumite substanțe/materiale pot pătrunde prin mănușile de examinare. Dacă TOKUYAMA ETCHING GEL HV sau EE-BOND vin în contact cu mănușile de examinare, îndepărtați și aruncați mănușile și spălați-vă bine pe mâini cu apă cât mai curând posibil.
6) Evitați contactul produselor TOKUYAMA ETCHING GEL HV sau EE-BOND cu ochii, mucoasele, pielea și hainele.
- Dacă TOKUYAMA ETCHING GEL HV sau EE-BOND vin în contact cu ochii, clătiți bine ochii cu apă și contactați imediat un medic oftalmolog.
- Dacă TOKUYAMA ETCHING GEL HV vine în contact cu mucoasele și pielea, ștergeți imediat zona afectată, clătiți bine cu apă și contactați imediat un medic.
- Dacă EE-BOND vine în contact cu mucoasele, ștergeți imediat zona afectată și clătiți bine cu apă după terminarea restaurării. Zonele afectate se pot albi din cauza coagulării proteinelor, dar o astfel de albire trebuie să dispară în răstimp de 24 de ore. Dacă o astfel de albire nu dispare în răstimp de 24 de ore, contactați imediat un medic, iar pacientul trebuie să fie instruit în acest fel.
- Dacă EE-BOND vine în contact cu pielea, îmbibați imediat zona cu un tampon de vată sau tifon înmuiat în alcool și clătiți cu apă.
- Dacă TOKUYAMA ETHNG GEL HV sau EE-BOND vin în contact cu hainele, îmbibați imediat zona cu un tampon de vată sau tifon înmuiat în alcool și clătiți cu apă.
- Instruiți pacientul să-și clătească gura imediat după tratament.
7) TOKUYAMA EE-BOND nu trebuie ingerat sau inhalat. Ingestia sau inhalarea pot cauza leziuni grave.
8) Pentru evitarea ingestiei neintenționate de TOKUYAMA EE-BOND, nu lăsați produsul nesupravegheat în îndemâna pacienților și copiilor.
9) NU expuneți EE-BOND sau vaporii săi la flacără deschisă deoarece EE-BOND este inflamabil.
10) Pentru evitarea contaminării încrucișate, NU reutilizați vârful de unică folosință și aplicatorul de unică folosință incluse în pachetul de TOKUYAMA EE-BOND.
11) După fiecare utilizare, curățați bine cu alcool recipientul de distribuire incluș în pachetul de TOKUYAMA EE-BOND.
12) Când utilizați un dispozitiv de fotopolimerizare, trebuie să purtați întotdeauna scuturi de protecție pentru ochi, ochelari sau ochelari de protecție.

■MĂSURI DE AVERTIZARE LEGATE DE MEDICAMENTE ŞI MATERIALE
1) Unele materiale și medicamente (materialul hemostatic) inhibă aderiunea produsului TOKUYAMA EE-BOND un timp îndelungat chiar și după curățarea meticuloasă cu apă. NU UTILIZAȚI produse care conțin:
- eugenol,
- peroxid de hidrogen,
- hipoclorit de sodiu,
- fluorură de diaminoargint [formula moleculară: $Ag(NH_3)_2F$],
- fenoli, apa cum sunt paraclorfenol, guaiacol, fenol,
- clorură de aluminiu,
- sulfat feric,
- sulfat de aluminiu,
- epinefrină.

2) Pentru evitarea amestecării produsului TOKUYAMA ETCHING GEL HV cu hipocloritul de sodiu incluș în materiale și medicamente, atunci când utilizați ambele materiale în aceeași procedură, clătiți bine înainte de utilizarea oricăruia dintre ele.

■DEPOZITAREA
1) Depozitați TOKUYAMA ETCHING GEL HV la temperaturi între 0 și 25°C (32 și 77°F).
2) Depozitați EE-BOND în frigider la temperaturi între 0 și 10°C (32 și 50°F).
3) Feriți de căldură, lumina solară directă, scântei și flăcări deschise.
4) NU utilizați după data expirării indicată pe seringă/sticlă/pachet.

■ELIMINAREA
Cantitățile neutilizate de TOKUYAMA ETCHING GEL HV și de EE-BOND trebuie absorbite cu un material absorbant inert, așa cum sunt tifonul sau vata, și eliminate în conformitate cu regulamentele locale.

■PROCEDURI CLINICE
1. Curățarea
Curățați bine suprafața dintelui cu o cupă de cauciuc și o pastă fără fluor, apoi clătiți cu apă.
2. Izolarea
Diga de cauciuc este metoda de izolare preferențială.
3. Pregătirea cavității
Pregătiți cavitatea și clătiți-o cu apă. Biloțați marginile de smalț ale preparațiilor anterioare (clasa III, IV, V) și teșiți marginile preparațiilor posterioare (clasa I, II) deoarece biloțărilor și teșiturile ajută la stergerea liniilor de demarcație dintre marginile cavității și restaurare, sporind aspectul estetica și retenția.
- În cazul reparării porțelanului/materialului compozit, aspriți suprafața cu o piatră sau frază diamantată în scopul pregătirii zonei pentru adeziune; aplicați TOKUYAMA ETCHING GEL HV pentru curățare; clătiți bine cu apă; uscați bine cu aer și tratați cu un reactiv de cuplare cu silan conform instrucțiunilor producătorului său.

4. Uscarea
Uscați cavitatea utilizând tehnica tamponării sau tehnica seringii cu aer.
- NU deseicați dintele vital. Deseicarea poate duce la sensibilitate după tratament.
- Substanțele menționate mai jos, care inhibă polimerizarea produsului EE-BOND, trebuie îndepărtate de pe suprafața dentară prin curățarea temeinică a suprafeței dentare cu alcool, acid citric sau prin aplicare de TOKUYAMA ETCHING GEL HV timp de 2 la 3 secunde înaintea aplicării:
  1) Resturile de ulei din piesa de mână,
  2) Saliva, sângele și exsudatele.

5. Protejarea pulpei
Trebuie să se aplice un material de căptușire cu glass-ionomer sau hidroxid de calciu în cazul în care cavitatea se află în vecinătatea pulpei. NU UTILIZAȚI MATERIALE PE BAZĂ DE EUGENOL pentru a proteja pulpa deoarece aceste materiale vor inhba polimerizarea produsului EE-BOND.
6. Gravarea smalțului
Atașați vârful de unică folosință după îndepărtarea capacului produsului TOKUYAMA ETCHING GEL HV. Verificați curgerea produsului TOKUYAMA ETCHING GEL HV înainte de a-l aplica intraoral. Aplicați TOKUYAMA ETCHING GEL HV (39% în greutate gel de gravare cu acid fosforic) numai pe marginea smalțului neșlefuit care înconjoară cavitatea pregătită și lăsați TOKUYAMA ETCHING GEL HV în repaus timp de 5 secunde. Clătiți bine suprafața gravată (cel puțin 5 secunde) cu apă și apoi uscați cu un jet ușor de aer. Îndepărtați vârful de unică folosință de pe TOKUYAMA ETCHING GEL HV și repuneți capacul seringii.
- Supraobturarea cu materiale compozite pe smalțul neșlefuit care nu a fost gravat poate cauza microdefecte marginale și coloratii.
- Smalțul șlefuit nu trebuie să fie gravat. Aplicarea de TOKUYAMA ETCHING GEL HV pe smalțul șlefuit nu va îmbunătăți sau afecta proprietățile adezive ale produsului EE-BOND la suprafața de smalțul șlefuit.
- Aplicarea de TOKUYAMA ETCHING GEL HV pe dentină poate reduce puterea adezivă a produsului EE-BOND față de dentină.

7. Distribuirea produsului EE-BOND
Deschideți capacul stielei de EE-BOND și distribuiți una sau două picături de EE-BOND în recipientul de distribuire. Imediat după distribuire, închideți strâns capacul stielei.
- Ștergeți excesul de adeziv de pe vârful picurătorului înainte de a-l închide.
- Nu amestecați adezivul cu alte mărci de primeri sau adezivi.

8. Aplicarea produsului EE-BOND
Aplicați EE-BOND pe pereții cavității, pe marginea acesteia și pe smalțul inconjurător neslefuit gravat, utilizând aplicatorul de unică folosință. Asigurați-vă că nu omiteți nicio zonă în care trebuie aplicat produsul EE-BOND. Lăsați în repaus timp de 10 secunde după terminarea aplicării.
- Proteja produsul EE-BOND distribuit și aplicatorul inserat de lumina ambientală înainte de aplicare, utilizând un scut de blocare a luminii.
- Finalizați aplicarea produsului EE-BOND în răstimp de 5 minute după distribuire deoarece conține un alcool volatil.
- În cazul restaurărilor multiple, asigurați un timp de aplicare individual pentru fiecare restaurare.
- Dacă saliva, sângele sau alte lichide contaminează produsul EE-BOND aplicat, clătiți bine cavitatea cu apă, uscați-o și reaplicați produsul EE-BOND.
- Nu clătiți produsul EE-BOND aplicat cu apă decât în cazurile de contaminare neintenționată.

9. Uscarea cu aer
Utilizând o seringă cu aer/apă degresate, aplicați un jet ușor de aer pe suprafața adezivului în mod continuu până când produsul EE-BOND cu tendință la curgere rămâne în aceeași poziție, fără a se mișca (de obicei timp de 5 secunde). La final utilizați un jet ușor de aer timp de 5 secunde sau mai mult. Utilizați un aspirator cu vid pentru a preveni împrăștierea produsului EE-BOND.
- Dacă se produce o împrăștiere accidentală, aceasta poate cauza albirea țesuturilor sau o posibilă reacție alergică.
- Pentru a preveni împrăștierea, consultați următoarele recomandări:
  1) Pentru evitarea unui jet de aer nedorit de putermic:
     a) Asigurați-vă în afara cavității bucale că începeți cu un jet de aer ușor,
     b) Direcționați jetul de aer pe suprafața produsului EE-BOND.
  2) Creșterea distanței seringii de aer/apă față de dinte reduce jetul de aer. Tehnica reflectării în oglindă este de asemenea utilă pentru reducerea jetului de aer.
  3) Dacă produsul EE-BOND se acumulează la baza cavității sau într-un unghi al suprafeței cavității și este prea gros pentru a fi subțiat cu jetul de aer, tamponați excesul cu un aplicator nou de unică folosință înainte de aplicarea jetului ușor de aer.

10. Fotopolimerizarea
Fotopolimerizați suprafața timp de 10 secunde sau mai mult, menținând vârful lămpii de polimerizare la o distanță de până la 2 mm de suprafață. Când cavitatea este prea mare sau prea distanțată (de ex. MOD), împărțiți zona în segmente și fotopolimerizați fiecare segment în mod individual.
- Verificați dacă dispozitivul de fotopolimerizare are o intensitate suficientă (>300 mW/cm²) înainte de a-l utiliza. Vă rugăm să aveți în vedere că un ghid de lumină crăpat va reduce intensitatea.

11. Materialul compozit fotopolimerizabil
Restaurați cu rășină compozită fotopolimerizabilă conform instrucțiunilor producătorului său. Supraobturați cu rășină compozită trebuie bine finisată și lustruită.
- Când într-o cavitate se aplică rășini compozite cu polimerizare duală, primul strat trebuie fotopolimerizat utilizând tehnica stratificării.
- Aici nu utilizați rășini compozite autopolimerizabile, deoarece monomerul de acid fosforic conținut în EE-BOND poate interfera cu polimerizarea rășinilor autopolimerizabile, ducând la detașarea prematură a acestora.

Utilizatorul și/sau pacientul trebuie să raporteze fabricantului și autorității competente din Statul membru în care domiciliază utilizatorul și/sau pacientul orice incident grav survenit în asociere cu dispozitivul.

Producătorul materialului TOKUYAMA EE-BOND nu este răspunzător pentru vătămările sau leziunile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestui produs. Este responsabilitatea personală a utilizatorului ca înainte de a aplica acest produs să se asigure că este adecvat pentru o aplicare corespunzătoare.
Specificările produsului TOKUYAMA EE-BOND constituie obiectul modificărilor fără notificare. Când se modifică specificările produsului, se pot schimba de asemenea instrucțiunile și măsurile prevenitive.

ESPAÑOL

Lea toda la información, precauciones y observaciones antes del uso.

■DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN GENERAL
1. TOKUYAMA EE-BOND es un sistema adhesivo odontológico fotopolimerizable y liberador de flúor que contiene TOKUYAMA ETCHING GEL HV (agente de grabado para técnica de grabado del esmalte) y EE-BOND (agente monocomponente de adhesión fotopolimerizable para la dentina y el esmalte).
2. La técnica de grabado del esmalte permite que EE-BOND forme una capa aglutinante duradera en la dentina y el esmalte debido a la buena penetración de EE-BOND en ambas estructuras dentales. TOKUYAMA EE-BOND posee excelentes propiedades adhesivas e integridad marginal con el es